

证券代码：301282

证券简称：金禄电子

公告编号：2026-005

## 金禄电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

#### 非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

本摘要的简称或名词释义与《金禄电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》相同。

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	金禄电子	股票代码	301282
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈 龙	谢 娜	
办公地址	清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区 M1-04,05A 号地	清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区 M1-04,05A 号地	
传真	0763-3698068	0763-3698068	
电话	0763-3983168	0763-3983168	
电子信箱	stock@camelotpcb.com	stock@camelotpcb.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。PCB 是以绝缘基板和导体为材料，按预先设计好的电路原理图，设计制成印制线路、印制元件或两者组合的导电图形的成品板，其主要功能是实现电子元器件之间的相互连接和中继传输。公司生产的 PCB 应用领域广泛，涵盖汽车电子、通信与算力、工控（机器人）与储能、消费电子、防务与航空航天、医疗器械等领域，其中尤以汽车电子、通信与算力、工控（机器人）与储能为主。

### (2) 所处行业基本情况

公司所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下属的“电子电路制造”，行业代码为 C3982。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为 C39。

PCB 被称为“电子产品之母”，广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域，是现代电子产品中不可或缺的电子元件，不可替代性是 PCB 制造行业得以长久稳定发展的重要因素之一，PCB 产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

经过数十年发展，PCB 行业已步入较为成熟稳定的发展阶段。2025 年是“十四五”收官之年，根据国家统计局发布的数据，全年实现国内生产总值 140.19 万亿元，同比增长 5.0%，其中规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业企业营业收入同比增长 7.4%，利润总额同比增长 19.5%。在汽车领域，根据中国汽车工业协会发布的数据，2025 年我国汽车产销分别完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%；其中新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，全年新能源汽车市场占有率达 47.94%，同比增加 7.01 个百分点。在通信领域，根据工信部发布的数据，截至 2025 年底，我国固定互联网宽带接入端口数达到 12.51 亿个，比上年末净增 4,877 万个；全国移动电话基站总数达 1,287 万个，比上年末净增 22.7 万个，其中 5G 基站为 483.8 万个，比上年末净增 58.8 万个；三家基础电信企业对外提供服务数据中心机架数量 93.8 万个，较上年增加 10.8 万个；手机产量 15.4 亿台，同比下降 5.8%，其中智能手机产量 12.7 亿台，同比下降 0.9%；5G-A（5G-Advanced）网络规模部署加速推进，在低空经济、工业互联网等商用场景相继落地，6G 系统架构与关键技术验证取得阶段性成果，人工智能与通信技术融合创新进程不断加快，量子通信技术从前沿研究走向应用落地。在服务器领域，根据 IDC 发布的《全球服务器市场季度追踪报告》，超大规模数据中心运营商和云服务提供商对嵌入式 GPU 服务器的快速采用，推动了服务器市场的增长——2025 年度全球服务器市场营收达 4,441 亿美元，同比增长 80.40%。根据海关总署统计数据，2025 年度我国印刷电路产品出口数量为 594 亿块，同比增加 30.5%；出口金额为 1,862.45 亿元，同比增加 29.7%。根据 PrismaMark2026 年 1 月的报告，2025 年度全球 PCB 产值预计为 848.91 亿美元，同比增长 15.40%，其中增速最快的细分应用领域为服务器/数据存储和有线基础设施，同比增幅分别达到 46.3%及 36.3%。

### (3) 所处行业地位情况

根据 CPCA 发布的《2024 中国电子电路行业主要企业营收榜单》，公司位列 2024 年度综合 PCB 百强第 41 位及内资 PCB 百强第 21 位。根据 Prismark 发布的 2024 年度全球 PCB 企业百强名单，公司位列 2024 年度全球 PCB 企业百强第 75 位。

PCB 产品种类多、应用领域广泛、定制化程度高，各类 PCB 产品在使用场景、性能、材质、电气特性、功能设计等方面各不相同。公司主要聚焦汽车 PCB，较早进入新能源汽车 PCB 领域并配合产业内龙头企业的需求进行技术研发、品质管控，积累了丰富的生产和品质管控经验，拓展了产业链内较多的优质客户资源，在新能源汽车 PCB 这一细分应用领域排名靠前、竞争优势较为明显。在整车领域，公司目前已和吉利、东风、长安、零跑、宇通及/或其下属零部件公司等建立直接合作关系；在动力电池 BMS 领域，公司 PCB 已配套应用于 2025 年度国内动力电池装机量排名前十企业中的八家企业的 BMS，并成为国内多家头部动力电池厂商及第三方 BMS 制造商的 PCB 主力供应商；在智能驾驶领域，公司客户群体较为广泛，已向速腾聚创、四维图新、豪恩汽电、福瑞泰克、佑驾创新等供货。

商业航天是公司下属特种 PCB 子公司近年来重点拓展的应用领域，该领域尤其是卫星用 PCB 产品需承受太空极端环境（高低温、真空、强辐射等）的影响，对可靠性和工艺技术要求极为严苛。在该领域，公司下属特种 PCB 子公司 PCB 产品应用于卫星及地面收发终端的相控阵天线、航天电源、时频装备和系统、传感器等，已和天奥电子、雷电微力等产业链内的部分企业建立直接合作关系。鉴于公司在该领域的 PCB 业务处于起步阶段，目前总体收入规模占比极低（2025 年度收入不足 1,000 万元，占比不足 0.5%），尚未对公司整体业绩构成重大影响。

#### （4）主营业务分析

2025 年度，公司深入贯彻既定发展战略，较好地完成了董事会制定的年度经营目标，现将全年主要工作情况总结如下：

##### ①经营业绩

2025 年度，公司实现营业收入 206,050.10 万元，首次突破 20 亿元大关，同比增长 28.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,039.67 万元，同比增长 12.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,217.73 万元，同比增长 45.65%；毛利率为 14.94%，同比增加 0.62 个百分点；经营活动产生的现金流量净额为 14,963.82 万元，同比增长 202.09%，在竞争日趋激烈、主要原材料价格大幅上涨的经营环境下延续了业绩稳健增长的良好态势。

##### ②市场拓展

2025 年度，公司围绕“智能电动汽车+大客户+新产业”三条主线卓有成效地开展营销工作。公司主营业务拓展纵深推进，全年承接的订单金额同比增加约 23%；客户订单结构持续优化，多层 PCB 收入占主营业务收入的比重达到 79.69%，同比增加 7.03 个百分点，贸易商客户收入占主营业务收入的比重降至 33.77%，同比减少 4.02 个百分点；智能电车业务更为突出，对某动力电池龙头企业及某第三方 BMS 头部制造商的销售收入同比均实现 50% 以上的增长，智能驾驶应用领域 PCB 收入规模呈现量级跃升，新导入豪恩汽电、福瑞泰克等行业知名客户；优质客户开发有的放矢，与零跑汽车、纬湃科技、清陶能源、珠海冠宇、移远通信、清能德创等建立合作关系；新兴产业布局循序渐进，

重点围绕人工智能、商业航天、算力基础设施、新型储能、低空经济等应用领域蓄势发力，技术进阶与市场挖掘双管齐下，积极培育增长新动能。

### ③科技创新

2025 年度，公司及子公司共投入研发费用 10,005.44 万元，同比增长 29.25%。全年申请专利 55 项，其中发明专利 24 项；获得专利授权 23 项，其中发明专利 14 项。“新能源汽车动力系统智能节材型厚铜多层线路板”、“智能电驱中央控制高密度互连线路板”、“三电集成系统高压电控高耐久性电路板”等 3 项产品获评“2025 年广东省名优高新技术产品”。开展了“新能源汽车 900V 平台电驱系统全参数高精度检测技术研究”、“AI 服务器 PCB 高密度布线与信号完整性增强关键技术的开发”、“工商储能产品高可靠性压合平整技术的研究与开发”、“基于工业机器人控制主板的混压技术研究与开发”、“PCB 用铜浆低温压力辅助烧结工艺的研发”、“基于 Anylayer HDI 加工技术的高速服务器 PCB 的研究与开发”等 57 个项目的研发工作。公司及子公司扎实推进新产品开发工作，一方面巩固和强化智能电动汽车领域的先发优势，配合下游客户成功研制并小批量量产固态电池 BMS 用 PCB，汽车 AI-box 用 PCB 已交付验证，基于 900V 高压架构的电驱 PCB 产品实现大批量交付；另一方面加快推进新兴产业应用领域的产品开发，应用于数据中心领域的 28 层刚性板已研制成功，采用铜浆烧结工艺的 22 层复合基板及 16 层软硬结合板、16 层高速刚性板已交付商业航天及防务等领域的客户，公司 PCB 产品正在围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶 HDI 等方向加速升级。

### ④产能建设

2025 年度，全资子公司湖北金禄按照既定计划通过添置设备扩充了部分产能，截至 2025 年末，公司广东清远、湖北安陆及四川遂宁三大生产基地已建成的 PCB 年产能超过 430 万平米。公司积极推进清远生产基地 PCB 扩建项目建设，截至 2025 年末已基本完成项目一期主体工程基础建设及主要生产设备订货工作，尚未进行装修及设备安装调试，进度不及预期，主要受两方面因素影响：一是当前 PCB 行业正处于以算力提升及 AI 应用为核心的技术革新周期，行业技术迭代速度远超预期，该项目在报告期内面向 AI 和算力进行产线适配，耗费了较多的时间进行厂房布局和设备选型的重新论证；二是 PCB 行业景气度明显提升，生产设备尤其是面向 AI 和算力的高端设备供不应求，较多设备的订货及交付周期比以往延迟 6-12 个月。截至 2025 年末，前述项目建设的可行性未发生重大变化。

### ⑤信息化提升

2025 年度，公司持续推进信息化建设工作，开发完善并新增 SAP ERP、OA 等系统部分功能模块，提升成本管控精细化水平和办公效率；全资子公司湖北金禄实施 MOM（制造运营管理）项目，与第三方合作运用人工智能大模型成功开发 MI 工程自动化软件并交付使用，助力公司 MI 工程资料处理效率与准确性的提升。全资子公司湖北金禄被工信部认定为“5G 工厂”。

此外，公司还被工信部认定为国家级绿色工厂。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	3,304,818,818.95	3,021,411,234.82	9.38%	2,726,158,347.59
归属于上市公司股东的净资产	1,717,935,347.90	1,675,504,857.53	2.53%	1,657,479,148.21
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	2,060,501,041.68	1,600,493,303.96	28.74%	1,331,099,728.86
归属于上市公司股东的净利润	90,396,723.78	80,191,036.05	12.73%	42,409,451.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,177,259.99	56,421,733.87	45.65%	25,540,039.79
经营活动产生的现金流量净额	149,638,246.88	49,534,980.95	202.09%	23,536,628.42
基本每股收益（元/股）	0.60	0.57	5.26%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.57	5.26%	0.28
加权平均净资产收益率	5.34%	4.76%	增加 0.58 个百分点	2.55%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	409,657,374.24	524,270,148.87	527,780,009.65	598,793,508.92
归属于上市公司股东的净利润	15,538,772.65	36,820,897.09	9,098,280.17	28,938,773.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,063,054.20	32,436,400.14	7,372,758.44	28,305,047.21
经营活动产生的现金流量净额	24,826,346.79	37,568,132.93	56,171,712.31	31,072,054.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,571	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
李继林	境内自然人	21.65%	32,720,000	32,720,000	不适用				0

麦睿明	境内自然人	9.85%	14,890,000	14,890,000	不适用	0
叶庆忠	境内自然人	7.95%	12,020,000	12,020,000	不适用	0
周敏	境内自然人	5.15%	7,790,000	7,790,000	不适用	0
叶劲忠	境内自然人	4.95%	7,480,300	0	不适用	0
共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	4,100,000	4,100,000	不适用	0
广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	1,467,167	0	不适用	0
叶国林	境内自然人	0.82%	1,239,900	0	不适用	0
贡俊	境内自然人	0.32%	481,100	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.28%	419,964	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		李继林与周敏系配偶，系公司实际控制人；叶庆忠与叶劲忠系兄弟；李继林系共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				

#### 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

#### 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

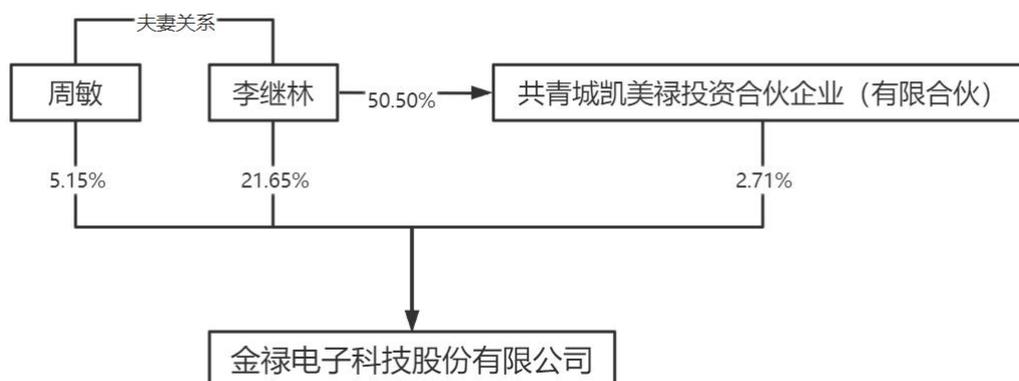
#### 公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

#### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



#### 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 1、关于与专业机构共同投资进展情况的说明

公司全资子公司深圳铠美诺作为有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国华以恒”），基金规模为人民币 4,500 万元，深圳铠美诺以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 44.44%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

报告期内，国华以恒以增资及/或受让股权的方式合计投资 2,105 万元与深圳南科天润能源有限公司、深圳北极芯微电子有限公司股东方、深圳市武测空间信息有限公司及其股东方、脑花科技（无锡）有限公司等签署投资文件，分别持有 4 家标的公司 2.78%、0.77%、4.45%及 2.30%的股权。截至本报告披露日，国华以恒已完成前述投资涉及的增资款及股权受让款的支付工作，前述标的公司均已完成股权变更登记手续。